

武汉金运激光股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司及其全资子公司经营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

- 1、公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度。
- 2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进一步协商后确定，相关授信及融资事项以正式签署的协议为准。
- 3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
- 4、董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

截至2021年4月21日，公司累计授信总计人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50%。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

此次董事会同意公司申请的不超过人民币10,000万元的授信额度,有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司前期未使用完的授信额度于该议案经2020年年度股东大会审议通过后不再使用。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2021年4月23日